

证券代码：688403

证券简称：汇成股份

合肥新汇成微电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-009

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	富国基金、中信保诚、园信永丰、远信投资、璞远资产、君和资本、磐厚资本、聚鸣投资、南土资产、彼得明奇基金、百年保险资管、光证资管、海通资管、财通资管、中信建投、中信证券、中金公司、海通证券、中邮证券、东方证券、长城证券等（排名不分先后）
活动时间	2023年9月6日-9月8日
活动地点	公司会议室
上市公司接待 人员姓名	副总经理 林文浩 董事会秘书 奚颢 财务总监 闫柳 证券事务代表 王赞 投资者关系经理 齐博
投资者关系活动主 要内容介绍	<p>1、问：公司当前在手订单如何？对下半年的订单情况、产品价格及毛利水平预期如何？</p> <p>答：公司目前在手订单相对充足，预计下半年订单及价格情况整体维持稳定。公司正积极通过调整产品结构提升盈利水平，预计 Q3、Q4 的单季毛利水平存在一定的提升空间。</p>

2、问：DDIC 产业链不同环节企业对于下半年预期存在一定的差异，面板厂及部分设计公司预期相对较保守，封测端目前预期相对较乐观，为何存在前述差异？

答：封测属于 DDIC 的中间代工环节，在整体消费电子产业链中处于相对上游的位置，终端消费市场的需求波动、显示面板及 DDIC 库存变化传导至封测环节具备一定的滞后性。同时，DDIC 产业链各环节存在一定的结构性差异，年内公司新拓展客户家数较多，设计公司面临的竞争一定程度上有所加剧，市场需求总量整体稳定且趋势向好，叠加台湾向大陆产业转移加速，可能会导致不同环节企业对于下半年预期存在一定的差异。

3、问：DDIC 产业链整体从台湾向大陆转移的趋势是否发生变化？

答：DDIC 产业链整体从台湾向大陆转移的趋势始终维持，从客户订单及产能需求预期等情况来看，产业转移的趋势在一定期间内可能会加速。

4、问：公司申请发行的可转债项目当前进展情况如何？募集资金主要用于什么产品？

答：公司本次发行可转债拟募集资金不超过 12 亿元，申请文件已于 2023 年 8 月被交易所受理，并已收到第一轮审核问询函，目前仍在推进过程中。本次拟发行可转债主要投向 OLED 等新型显示驱动芯片先进封测扩产项目，项目建成后，将能有效提高公司 OLED 等新型显示驱动芯片的封装测试能力，提高盈利能力。

5、问：为什么显示驱动芯片都使用金凸块？有其他材料的凸块可以替代吗？

	<p>答：黄金具有极佳的电气性能、机械加工性和热稳定性。相比铜柱凸块等其他技术，金凸块可以使芯片与基板之间的连接更为稳固，具备更佳的抗静电能力、散热能力并且能够提供一定程度的物理保护。目前显驱芯片上很少使用其他类型的凸块技术。</p>
附件清单（如有）	无
上传日期	2023年9月11日